



多晶片固晶模組 自動化技術

Automatic Multi-Chip Die-Bonding Module Technology

張心豪

工研院機械所
先進製造技術組
先進封裝技術部

林冠廷

工研院機械所
先進製造技術組
先進封裝技術部

黃萌祺

工研院機械所
先進製造技術組
先進封裝技術部
經理

關鍵詞(Keywords)

- 固晶技術 Die-Bonding
- 多晶片模組 Multi-Chip Module
- 取放技術 Pick and Place Technology

摘要(Abstract)

取放機構技術具有高定位重現性、高生產速度以及高產量等特點，能有效節省人力資源與大幅降低產品成本，廣泛應用於半導體產業設備之中。隨者半導體製程技術近年快速發展，對於取放機構技術的定位精度以及生產效率也相對要求提升，因此本文針對目前業界所應用之技術架構以及取放技術新興發展的現況進行介紹。

Pick and place technology (PAPT) takes advantage of high positioning repeatability, high production speed and high throughput to save labor and costs. It has been recognized as a popular and effective module used in semiconductor equipment. The positioning accuracy and production efficiency of PAPT must be improved to keep pace with the rapid development of semiconductor process technology. Therefore, this article introduces the current status of applied technology architecture and emerging developments of PAPT

1. 前言

半導體產業已成為台灣不可缺少的經濟命脈，於開發過程中也同時帶動相關生產設備與材

更完整的內容

請參考【機械工業雜誌】387期・104年6月號

每期220元・一年12期2200元

劃撥帳號：07188562 工業技術研究院機械所

訂書專線：03-591-9342

傳真訂購：03-582-2011

機械工業雜誌官方網站：www.automan.tw